ー軸延伸ポリイミド薄膜の光学リターデーションおよび 面内複屈折の温度依存性の解析

東工大院理工 〇保田 雄亮・松田 祥一・照井 貴陽・安藤 慎治

[要旨] 3種類 (BPDA/PDA, PMDA/ODA, PMDA/TFDB)の一軸延伸ポリイミド薄膜 の光学リターデーション [$R=\Delta n_{yx}$ (面内複屈折)×d(膜厚)]の温度依存性について 解析を行なった。温度上昇において面内複屈折の減少に比して膜厚膨張の影響が 小さいポリイミドではR値が減少し、膜厚膨張の影響が大きいポリイミドにおい てはR値が増加した。また、偏光 ATR FT-IR 法を用いて固有複屈折(Δn^{0})の算出を 行った。[BPDA/PDA:0.51, PMDA/ODA:0.33($@\lambda$ =1307 nm]

1. 緒 言

近年の集積光学技術の発展により、光波長板や偏光子、光アイソレータなど光 の偏波状態を制御する光学部品が導波路型光回路や光配線基盤上に集積化するこ とが要請されている[1]。その中で、一軸延伸ポリイミド薄膜の大きな光学リター デーション(R)を利用した光波長板が、Si基板上に作製された石英系導波回路に おける偏波依存性を解消するために広く用いられている[2]。このような複屈折性 光学部品の温度特性の評価には、Rの温度依存性に関する知見が不可欠である。 そこで本研究では一軸延伸ポリイミド薄膜のRの温度依存性および面内複屈折 ($\Delta n_{\rm vx}$)の温度依存性について解析を行なった。また、偏光ATR FT-IR法[3]を用い て Δn^0 の算出も行なった。

2.実験

2-1. 試料調製

BPDA/PDA、PMDA/ODA、PMDA/TFDB (Fig.1(a-c))の3種類の剛直性芳香族ポリイミ ドのRの温度依存性を測定した。 備光ATR FT-IR測定によるPMDA/TFDBのΔn⁰は既に報 告されている[3]ため、BPDA/PDAとPMDA/ ODAに対してのみ解析を行った。ポリイミ ド薄膜試料は、前駆体であるポリアミド酸を 成膜後、TMA (真空理工:TM-7000)を用い一軸 延伸・加熱イミド化により調製した[3,4]。

Fig.1 Molecular structure of (a) BPDA/PDA

(b) PMDA/ODA and (c)PMDA/TFDB

polyimides (Pls).

2-2. 測 定

R 測定は平行ニコル回転法 [4] により、また、試料の加熱はホットステージ (Mettler Toledo: FP82HT) にて行った。Rの温度依存性は 40 ~ 180°C の温度領域に おいて 20°C おき、降温過程にて測定を行った。Si 基板上に作製されたポリイミ ド薄膜の膜厚方向の CTE 測定は分光エリプソメトリー(ヒートステージ付) (J.A. Woollam Japan. Co: M-2000U)を用いて行なった。測定は降温過程において 50 ~ 190°C で行ったが、水分吸着の影響を避けるために 100°C ~ 190°C での測定デー タを解析に用いた。

3.結果と考察

3-1. ポリイミドの固有複屈折 (∆nº) の算出

BPDA/PDAとPMDA/ODAポリイミドの偏光 ATR FT-IR法により求めた分子配向度 (<cos²(yY)>-<cos²(yX)>)と面内複屈折(Δn_{yx})の 関係をFig.2に示す。これらは線形関係にある ため、切片から Δn° を算出することが可能であ り[3]、得られた値はBPDA/PDAで 0.51($@\lambda$ =1307 nm)、PMDA/ODAで 0.33($@\lambda$ =1307 nm)であった。BPDA/PDAの Δn° は、密度汎関数法による計算値が 0.47 (λ =1320



Fig.2 Intrinsic birefringence(Δn^0) for PIs.

nm)[5]、冷間延伸試料を用いて算出された値が 0.66 (λ =589 nm)[6] と報告されてい る。実測値が計算値よりも大きいのは、延伸処理により結晶性が上昇(配向結晶 化)し密度が上昇したためと考えられる。また、実験による文献値よりも小さい のは複屈折の波長分散(波長が短いほど Δn^0 は増加)の影響である。一方、PMDA/ ODAにおいては計算から得られた値は 0.37 (λ =1320 nm)[5]、実験により得られた 値は 0.33 [7] であり、本研究で得られた値とよく一致している。また、PMDA/TFDB については Δn^0 =0.33 であると報告されている。BPDA/PDAの Δn^0 は他のポリイミ ドと比較しても非常に大きい。これは分子構造の直線性が高いこと、また、繰り 返し単位中の芳香環の割合が高く、平均屈折率が高い[8] ことによる。

3-2. 光学リターデーション(R)の温度依存性の解析

Fig.3 に 3 種の一軸延伸ポリイミド薄膜の R の温度依存性を示す。BPDA/PDA と PMDA/ODA は温度の上昇とともに R 値が減少することが、一方、PMDA/TFDB は 増加することが確認された。また、BPDA/PDA と PMDA/ODA は R 値が小さくなる と R の減少量が小さくなり、PMDA/TFDB も R 値が小さくなるとその増加量が小 さくなることが示された。これは R の温度による変化がそれぞれのポリイミドに









固有であり、R が変化してもほぼ一定のためである。

R は面内複屈折 (∆n_{vv}) と膜厚 (d) の積であるので、温度上昇による R の変化を 解析するには、Δn_{vx}とdの温度変化を個別に測定する必要がある。そこで、ポリ イミドの膜厚方向の CTE 測定を分光エリプソメトリーを用いて行ったところ、各 ポリイミド薄膜の膜厚方向の CTE は、BPDA/PDA: 152 ppm/K, PMDA/ODA: 164 ppm/ K、PMDA/TFDB: 188ppm/K であった。ポリイミド薄膜の膜厚方向の CTE は、面内 における膨張が Si 基板によって強く拘束されるため、体積膨張率と同程度と考え られる。ここから、BPDA/PDAは結晶性が高く体積膨張率が小さいためにCTEが 最も小さく、一方、PMDA/TFDB はかさ高いトリフルオロ基を側鎖に有している ため体積膨張が大きいことから、膜厚方向のCTE も大きいと解釈できる。次い で、RとCTEの温度依存性から Δn_{vv}の温度依存性を算出したところ (Fig.4)、全て のポリイミドにおいて、温度の上昇に伴い Δn_{vx} 値が減少した。また、Δn_{vx} 値が小 さいほどその温度依存性も小さくなる。さらに得られた Δn_{vx} に対して Δn_{vx}の温度 依存性 (d⊿n_{yx}/dT) をプロットしたところ、∆n_{yx} の増加とともに d⊿n_{yx}/dT もほぼ線 形に変化していくことが示された(Fig.5)。一方、Rの温度依存性は、Rの温度微 分式(下式)より温度上昇にともなう ∆n_{vx} の減少と膜厚膨張のどちらの影響が強 いかによりその値の増減が決まる。ここで膜厚をDとおいた。

$$\frac{dR}{dT} = D \times \frac{d\Delta n_{YX}}{dT} + \Delta n_{YX} \times \frac{dD}{dT}$$
(1)

以上より、BPDA/PDA と PMDA/ODA は温度上昇 によって減少する Δn_{YX} の影響よりも膜厚増加 の影響が小さいために R 値は減少し、一方、 PMDA/TFDB は減少する Δn_{YX} の影響よりも膜厚 膨張の影響が大きいために R 値が増加したと 理解できる。

また、PMDA/TFDB は正の温度依存性を示 し、PMDA/ODA は負の温度依存性を示すこと



Fig.5 Relationships between $d\Delta n_{yx}/dT$ and Δn_{yx} for Uniaxially drawn PI films.

から、これらの共重合体を用いれば R の温 度依存性の小さなポリイミドが作製可能で あると考えられる。そこで、これらの共重 合体 [ODA:TFDB=1:2] を新たに調製した。 Fig6 に各ポリイミドのそれぞれの温度にお けるリターデーションの変化の割合の平均 値を示す(エラーバーは延伸比の異なる試料 によるもの)。これより、PMDA/ODA と PMDA/TFDBの共重合体は非常に小さな温度 依存性を有することが示された。この結果 は光学リターデーションに温度依存性が存 在しない(アサーマルな) 複屈折材料が調整 可能であることを示している。



Fig. 6 Temperature dependence of optical retardation (R) for homo-and copolyimides.

4. 結論

3種の一軸延伸ポリイミド薄膜を用いて R の温度依存性を測定し解析を行った。 また、偏光 ATR FT-IR 法を用いてこれらポリイミドの Δn^{0} (@ λ =1307 nm)を算出し た (BPDA/PDA:0.51, PMDA/ODA:0.33)。BPDA/PDA の非常に大きな Δn^{0} は分子構造 の直線性が高いこと、繰り返し単位中の芳香環の割合が高いため密度が上昇する とともに屈折率が上昇したことによる。また、Si 基板上に作製されたポリイミド 薄膜の膜厚方向の膨張率は体積膨張率の大きさの順序と同じとなった (BPDA/ PDA:152 ppm/K, PMDA/ODA:164 ppm/K, PMDA/TFDB:188 ppm/K)。Rの温度依存性 は、温度上昇において膜厚膨張の影響が小さいポリイミド (BPDA/PDA, PMDA/ ODA) では R 値が減少し、膜厚膨張の影響が大きいポリイミド (PMDA/TFDB) では R の値が増加した。

謝辞:温度可変分光エリプソメトリーの測定と解析にご協力いただきました J.A.Woolam社と同社の堤浩一様にお礼を申し上げます。

参考文献

- [1] H. Ma, A. K. Y. Jen, and L. R. Dalton, Adv. Mater., 14, 1330 (2002).
- [2] S. Ando, T. Sawada, and Y. Inoue, *Electron. Lett.*, 29, 2143 (1993).
- [3] S. Matsuda and S. Ando, J. Polym.Sci. Part B; Polym Phys., 41, 418 (2003).
- [4] S. Ando, T. Sawada, and S. Sasaki, Polym. Adv. Technol., 12,319 (2001).
- [5] Y. Terui and S. Ando, J. Polym.Sci. Part B; Polym Phys., 42(12),2354 (2004).
- [6] M. Hasegawa, N. Sensui, Y. Shindo, and R. Yokota, Macromolecules, 32, 387 (1999).
- [7] C. Cha and R. J. Samuels, SPE ANTEC., 39, 2896 (1993).
- [8] S. Ando, Y. Watanabe, and T. Matsuura, Jpn. J. Appl. Phys., 41, 5254 (2002).